

前 言

本标准等同采用国际标准 IEC 747-1:1983《半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则》。1991年9月,IEC 747-1作了第一次修订;1993年10月,IEC 747-1作了第二次修订。本标准包括了这两次修订的内容。

由于 IEC 747-1 作了两次修订,使图号的顺序打乱,本标准根据图出现的先后顺序重新编排了图号。

本标准的第 I 篇至第 II 篇是对 IEC 747 和 IEC 748 这两套标准的范围、说明和要求,不涉及具体内容,为便于和 IEC 标准等同,仍保留这三篇。但因我国标准给号与 IEC 不同,不便于叙述,故仍直接使用 IEC 标准号叙述。IEC 标准与国家标准对应如下:

IEC 747-1	GB/T 17573—1998
IEC 747-2	GB/T 4023—1997
IEC 747-3	GB/T 6571—1995
IEC 748-1	GB/T 16464—1996
IEC 748-2	GB/T 17574—1998

本标准由中华人民共和国电子工业部提出。

本标准由全国半导体器件标准化技术委员会归口。

本标准由电子工业部标准化研究所负责起草。

本标准主要起草人:王长福、顾振球、吴逵、干丽芬。

IEC 前言

1) IEC(国际电工委员会)在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。

2) 这些决议或协议,以推荐标准的形式供国际上使用,并在此意义上为各国家委员会所认可。

3) 为了促进国际间的统一,IEC 希望各国家委员会在本国条件许可的情况下,采用 IEC 标准的文本作为其国家标准,IEC 标准与相应国家标准之间的差异,应尽可能在国家标准中指明。

本标准是国际电工委员会第 47 技术委员会(半导体器件和集成电路)制定的。

IEC 747-1 标准构成半导体器件通用标准的第一部分,它给出的是通用条文。IEC 747-2、IEC 747-3 等标准中的每一个标准,是给某一种类型的器件提出补充条文。

1982 年 9 月在伦敦举行的第 47 技术委员会会议上,批准了将 IEC 147 和 IEC 148 标准改编成现行的按器件编排的建议。由于所有的组成部分都已预先按“六个月法”或“二个月程序”表决批准,因而无需重新表决。

IEC 147 和 IEC 148 标准中有关集成电路的内容已包括在 IEC 747-1 和 IEC 748 标准中。

IEC 147-5 和 IEC 147-5A 标准中有关机械和气候试验方法的内容,已包括在 IEC 749 标准中。

中华人民共和国国家标准

半导体器件 分立器件和集成电路 第 1 部分:总则

GB/T 17573—1998
idt IEC 747-1:1983

Semiconductor devices
Discrete devices and integrated circuits
Part 1:General

第 I 篇 IEC 747 和 IEC 748 标准的范围和说明

1 IEC 747 标准

1.1 范围

IEC 747 标准包括如下内容:

- 分立器件和集成电路的通用标准;
- 为完善分立器件标准用的补充标准。

1.2 说明

IEC 747 标准由单行本 IEC 747-1、IEC 747-2 等几个标准组成。通过发布补充件,例如 IEC 747-1A,来跟上时代的发展。

2 IEC 748 标准

2.1 范围

IEC 748 标准应与 IEC 747-1 标准一起使用。IEC 748 标准给出了有关集成电路的标准。

2.2 说明

IEC 748 标准由单行本 IEC 748-1、IEC 748-2 等几个标准组成,通过发布补充件,例如 IEC 748-1A 来跟上时代的发展。

第 II 篇 IEC 747-1 标准的目的和说明

1 目的

- 提供有关 IEC 747 和 IEC 748 标准(见第 I 篇)的范围和说明的通用内容;
- 提供有关适用于 IEC 747-2、IEC 747-3 等各类或各分类分立器件标准的一般原则或要求的内容。

2 说明

有关一般原则或要求的内容在 IEC 747-1 标准的第 II 至第 IX 篇中给予说明。

注:第 II 至 IX 篇的内容;